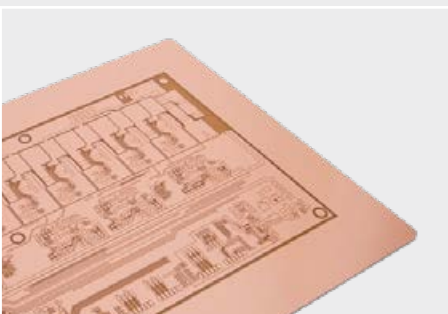
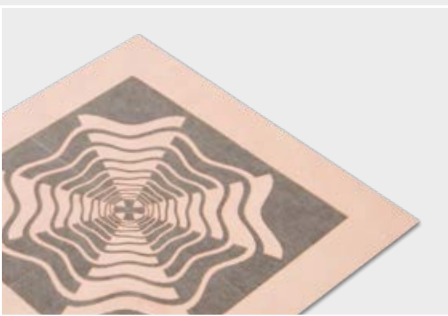


プリント基板試作用レーザー装置 LPKF ProtoLaser S4

- プリント基板加工のスペシャリスト
- レーザー波長 532 nm のグリーンレーザーを搭載
- 信頼と実績の LPKF レーザー加工
- 最新のマシン設計
- ユーザーフレンドリーな CircuitPro 付属



LPKF ProtoLaser S4:
プリント基板試作のスペシャリスト



プリント基板試作用レーザー装置 - 新型レーザーと高速位置認識システムを搭載した ProtoLaser S4

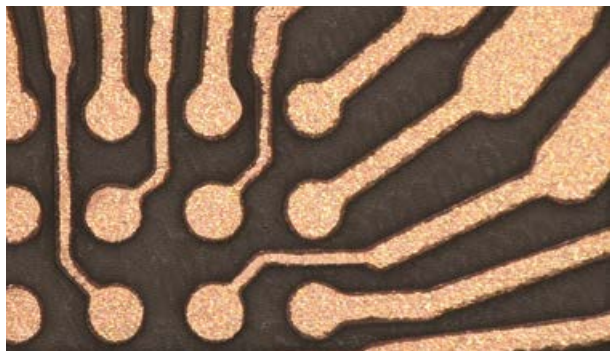
迅速で正確なPCB試作にはレーザー加工が最適です。従来のマシニング加工よりも正確で、応用範囲が広く、加工コストも抑えることができます。LPKF ProtoLaser S4 は前モデルより広い用途に使用できる新型モデルです。

新しいデザイン

LPKF ProtoLaser S4 の特徴はその洗練された装置デザイン、操作やメンテナンスがしやすい設計にあります。制御用PC内蔵オプションもご用意しています。

運用コスト

ProtoLaser S4 は電子系の研究室に最適なツールです。精密なプリント基板をすぐに作ることができ、広いエリアも特別な加工技術を使用してすばやく加工します。マスクや工具が必要なく、小ロットの基板や個別のデザインを簡単に作成できます。



LPKF ProtoLaser S4にてPCB高精度加工を実現

加工条件

グリーンレーザーを使用することで加工アプリケーションの幅が広がりました。基材に対するダメージも最低限に抑えられます。電解めっきにてピアを作成した基板のような厚みにばらつきのある金属箔も確実に加工することもできます。ProtoLaser S4 は厚み0.8 mmまでのリジッド基板、フレキシブル基板もカットすることもできます。

カメラシステム

LPKF ProtoLaser S4 はプリント基板試作に最適化された新型のカメラと画像処理システムを搭載。高い解像度と迅速な検知アルゴリズムにより、試作プロセスがさらに早くなりました。

ソフトウェア

CAMソフトウェア LPKF CircuitPro が付属しています。このソフトウェアではデータの編集と装置の制御ができ、全ての加工パラメータを設定することができます。標準材料や特殊材料についての加工パラメータライブラリがあらかじめセットされており、編集することもできます。

技術データ: LPKF ProtoLaser S4

加工サイズ (X x Y x Z)	229 mm x 305 mm x 10 mm (9" x 12" x 0.4")
レーザー波長	532 nm
レーザーパルス周波数	25 kHz - 300 kHz
加工スピード	650 mm/s (25"/s) on 18 µm / ½ oz Cu on FR4
レーザースポット径	23 µm (0.9 mil)
最小ライン/スペース	75 µm/25 µm (2.9 mil/1 mil), ラミネート基材の場合 (18 µm Cu)
精度*	± 1.98 µm (± 0.08 mil)
装置寸法 (W x H x D)	910 mm x 1650 mm x 795 mm (35.8" x 65" x 31.3"); ドアオープン時の高さ 1765 mm (69.5")
装置重量	340 kg
電源	110 V - 230 V; 1.4 kW
エア	6 bar (87 psi)以上, 230 l/min (8.12 cfm)以上
必要装備	集塵機、PC、圧縮エア

* スキャナ精度

LPKF Laser & Electronics 株式会社 〒273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目1-1 ららぽーと三井ビルディング8F
Phone +81 (0) 47 432 5100 info.japan@lpkf.com http://jp.lpkf.com



© LPKF Laser & Electronics 株式会社は、予告なく使用および製品情報を変更する場合があります。